

绿光精密激光切割机

GREEN LIGHT PRECISION LASER CUTTING EQUIPMENT

切口质量优

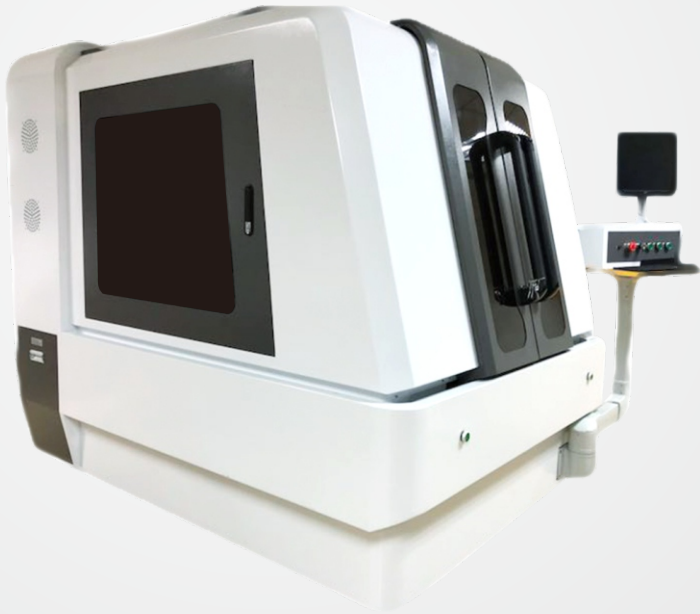
激光切割无毛边无碳化

加工效率高

切割速度快,能在短时间内完成大量材料的切割

无接触切割

无需与材料接触,不会对材料产生机械应力变形



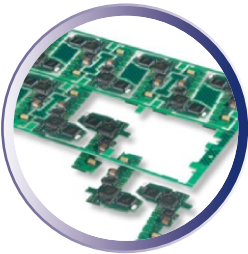
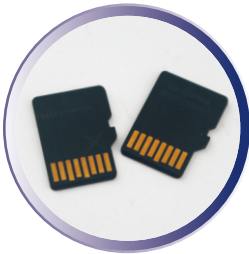
产品概述 / Product Overview

设备采用高性能进口绿光激光器。激光束经光路系统聚焦到待切割材料表面,高能量密度的激光使材料瞬间分离,同时通过控制系统驱动,实现精确的切割作业。功率稳定衰减小,光速质量佳,聚焦光斑小,热影响区趋近于零,有效提高切割质量,保证产品品质;配备精密高速振镜扫描头,稳定、精准、高速,加工过程无耗材,大幅讲题运行成本与加工效率。

应用领域 / Application Fields

设备广泛应用于LED陶瓷衬底、TF卡、SD卡、指纹模组、VCM、PCB板、BGA、CSP、QFN等高分子脆性材料的切割和分板。

样品展示 / Sample Showcase



PCB分板

SD内存卡

PCB分板

TF内存卡

产品优势 / Product Advantages

- 高精度
聚焦光斑小,能实现高精度切割,设备综合精度可达 $\pm 0.02\text{mm/m}$;
- 热影响区小
采用冷加工模式,切割过程中热影响区域小,有效减少材料变形和损坏,不易损坏线路和焊盘等;
- 切割质量优
切割边缘光滑整齐,无毛刺、无碳化,切口窄,加工效果理想;
- 切割效率高
切割速度快,能在短时间内完成大量材料的切割,且随着激光器功率的提升,加工效率也会相应提高;
- 非接触式加工
激光切割无需与材料接触,不会对材料产生机械应力变形、划伤。

技术参数 / Technical Specifications

设备型号	IT-LCG-CD35、IT-LCG-CD70
激光功率	35W/70W
定位精度	0.02mm/m
CCD定位精度	$\pm 3\mu\text{m}$ @200万像素
平台重复精度	$\pm 2\mu\text{m}$
平台定位精度	$\pm 4\mu\text{m}$
切割尺寸精度	$\pm 30\mu\text{m}$